

Title (en)  
Method for applying adhesives

Title (de)  
Verfahren zum Auftragen von Klebstoff

Title (fr)  
Procédé d'application d'adhésifs

Publication  
**EP 1577020 A2 20050921 (DE)**

Application  
**EP 05004393 A 20050301**

Priority  
DE 102004013845 A 20040320

Abstract (en)  
The adhesive application device applies an adhesive to the surface (50) of a component (5). The device includes a sonotrode (1), containing a channel (10) for the supplier that he is in. The channel has an adhesive outlet aperture (11) in the region of the free head end of the sonotrode. Sonotrode vibrations are transmitted to the adhesive as it comes out of the output aperture.

Abstract (de)  
Es soll eine neue Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf eine Fügeoberfläche eines Fügeteils geschaffen werden, die aufwendige Reinigungs- und Oberflächenvorbehandlungsschritte vor dem Auftragen des Klebstoffs auf die Substatoberfläche vermeidet bzw. mit der sich auch bei nicht vermeidbarer Kontamination oder Rekontamination eine ausreichende Qualität von Klebungen sicherstellen lässt und die darüber hinaus effektiv arbeitet. Die neue Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf eine insbesondere kontaminierte Fügeoberfläche (50) eines Fügeteils (5) weist folgende Merkmale auf: #c die Vorrichtung umfasst eine Sonotrode (1), #c in der Sonotrode (1) ist ein Kanal (10) für die Zuführung von Klebstoff angeordnet, #c der Kanal (10) weist eine Kleberaustrittsöffnung (11) auf, die im Bereich des freien Kopfendes der Sonotrode (1) angeordnet ist, #c die Sonotrode (1) ist so ausgebildet, dass im Betrieb die Schwingungen der Sonotrode (1) auf den aus der Kleberaustrittsöffnung (11) heraustretenden Klebstoff übertragen werden.

IPC 1-7  
**B05B 17/06**; **B05C 5/02**; **C09J 5/00**

IPC 8 full level  
**B05C 5/02** (2006.01); **B05C 9/08** (2006.01); **B05C 11/10** (2006.01); **B05D 5/10** (2006.01); **C09J 5/00** (2006.01); **B05B 17/06** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**B05C 5/02** (2013.01 - EP US); **B05C 11/1034** (2013.01 - EP US); **B05B 17/06** (2013.01 - EP US); **Y10T 156/1798** (2015.01 - EP US)

Citation (applicant)  
• DE 10312815 A1 20041007 - HENKEL KGAA [DE]  
• DE 4226312 A1 19940210 - KERSTNER RALPH [DE]  
• JP S63132788 A 19880604 - MIYACHI ELECTRIC CO, et al  
• JP 2000073031 A 20000307 - MITSUI HIGH TEC  
• US 6544364 B2 20030408 - MAEDA HIDEJI [JP], et al  
• DD 205180 A1 19831221 - RUHSLAND KLAUS, et al  
• JP H01259080 A 19891016 - MORIKAWA SANGYO  
• JP H0657229 A 19940301 - KANEGAFUCHI CHEMICAL IND  
• DE 19858921 A1 20000621 - HENKEL TEROSON GMBH [DE]  
• DE 19502381 A1 19960801 - TEROSON GMBH [DE]

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1577020 A2 20050921**; **EP 1577020 A3 20080319**; **EP 1577020 B1 20090826**; AT E440675 T1 20090915; DE 102004013845 B3 20051103; DE 502005007969 D1 20091008; US 2005238819 A1 20051027

DOCDB simple family (application)  
**EP 05004393 A 20050301**; AT 05004393 T 20050301; DE 102004013845 A 20040320; DE 502005007969 T 20050301; US 8453005 A 20050318